

Etchant for Ni-Cr sputtered seed layers

FLICKER

フレキシブルプリント配線板シード層除去液

メタライズ法2層 CCL のシード層除去に最適。

電子機器の小型化に伴いプリント配線板の回路の微細化、高密度化が進んでおり、その実現のためには配線板の絶縁が不可欠となっています。FLICKER は、銅配線をほとんど侵さずに配線間に残存したシード層を選択的に除去します。

● 用途

メタライズ法2層 CCL 材を使用したフレキシブルプリント配線板のシード層 (NiCr 合金) 除去



● 特長

- ① サブトラクティブ工法、セミアディティブ工法、両方に使用できます。
- ② 銅をほとんど侵さずにシード層を選択的に除去します。
- ③ 管理方法が容易です。
- ④ 液の安定性に優れています。

● 作業条件

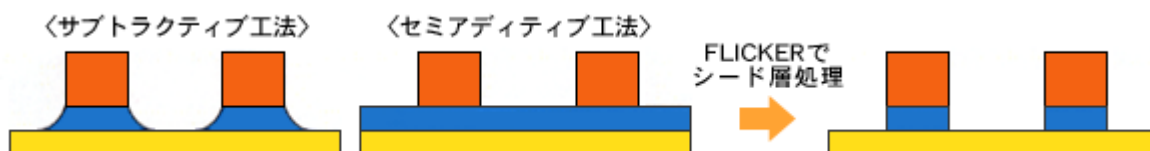
処理温度	45~60 °C
処理時間	30~120 sec
処理方法	浸漬及びスプレー処理

※処理温度・時間はシード層のみ、基材のタイプにより調整が必要です。

● 使用例

サブトラクティブ工法では、塩化鉄もしくは塩化銅での銅エッチングにご使用ください。

セミアディティブ工法では、銅めっきによる銅配線形成を行いレジスト除去、フラッシュエッチング後にご使用ください。



サブトラクティブ工法におけるFLICKERによるシード層除去効果



塩化鉄（塩化銅）で作成したTEGにFLICKER処理を行いました。その後、ニッケルめっきを行い異常析出の有無によりシード層のエッチング残渣を確認しました。